

## 先端半導体パッケージ向けハイブリッド接合前処理装置「HSM-1000」の販売を開始

芝浦メカトロニクス株式会社は、先端半導体パッケージ向けハイブリッド接合前処理装置「HSM-1000」の販売を開始しました。

本製品は、高性能サーバ、生成 AI、高性能 PC 向けのロジック半導体やメモリ、イメージセンサなどの先端半導体パッケージに採用が拡大しているハイブリッドボンディングおよびフュージョンボンディングの接合前処理を行う装置です。

先端半導体パッケージ分野では、マイクロバンプの微細化限界を背景に、バンプレス接合技術であるハイブリッドボンディングへの注目が高まっています。接合品質を確保するためには、プラズマ活性化や洗浄、リンスなど複数の前処理工程が必要であり、これらを集約した装置や実装工程までをカバーするワンストップソリューションへのニーズが拡大しています。

「HSM-1000」は、当社が長年培ってきた真空プラズマ技術、洗浄技術、自動化技術を融合し、ハイブリッドボンディングに必要な接合前処理工程を 1 台で実現する装置です。

当社は、ハイブリッドボンダとの組み合わせによるトータルソリューションを提供し、先端半導体パッケージ市場におけるさらなる事業拡大を目指してまいります。

### ■ 先端半導体パッケージ向け ハイブリッド接合前処理装置 「HSM-1000」



### ■ 特長

- ・高性能サーバや生成 AI に用いられるロジックやメモリ分野、また高性能イメージセンサ分野でのハイブリッドボンディングプロセスに求められる接合前処理プロセスを 1 台で実現
- ・各プロセスユニットの最適配置によりトップウェーハとボトムウェーハの WPH:  $\geq 10$ sets を達成(当社指定条件)
- ・ハイブリッドボンダとのインテグレーションによるワンストップソリューションを提供

### 【お問い合わせ先】

芝浦メカトロニクス株式会社

メカトロニクスシステム事業部

<https://www.shibaura.co.jp/inquiry/index.html>